

Dell EMC PowerEdge R750xs

Teknik Özellikler

Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarılar

 **NOT:** NOT, ürününüzü daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak önemli bilgiler sağlar.

 **DİKKAT:** DİKKAT, donanım hasarı veya veri kaybı olasılığını gösterir ve sorunu nasıl önleyeceğinizi bildirir.

 **UYARI:** UYARI, mülk hasarı, kişisel yaralanma veya ölüm potansiyeline işaret eder.

Bölüm 1: Teknik özellikler	4
Kasa boyutları.....	5
Sistem ağırlığı.....	5
İşlemci özellikleri.....	6
PSU teknik özellikleri.....	6
Desteklenen işletim sistemleri.....	7
Soğutma fanı özellikleri.....	7
Sistem pili özellikleri.....	9
Genişletme kartı yükselticisi teknik özellikleri.....	9
Bellek özellikleri.....	10
Depolama denetleyicisi özellikleri.....	10
Sürücüler.....	10
Bağlantı noktaları ve konektörlerin özellikleri.....	11
USB bağlantı noktalarının özellikleri.....	11
Seri konektör özellikleri.....	11
NIC bağlantı noktası özellikleri.....	11
VGA bağlantı noktalarının teknik özellikleri.....	11
Video özellikleri.....	11
Çevre özellikleri.....	12
Partikül ve gaz kirliliği teknik özellikleri.....	13
Termal kısıtlama matrisi.....	14

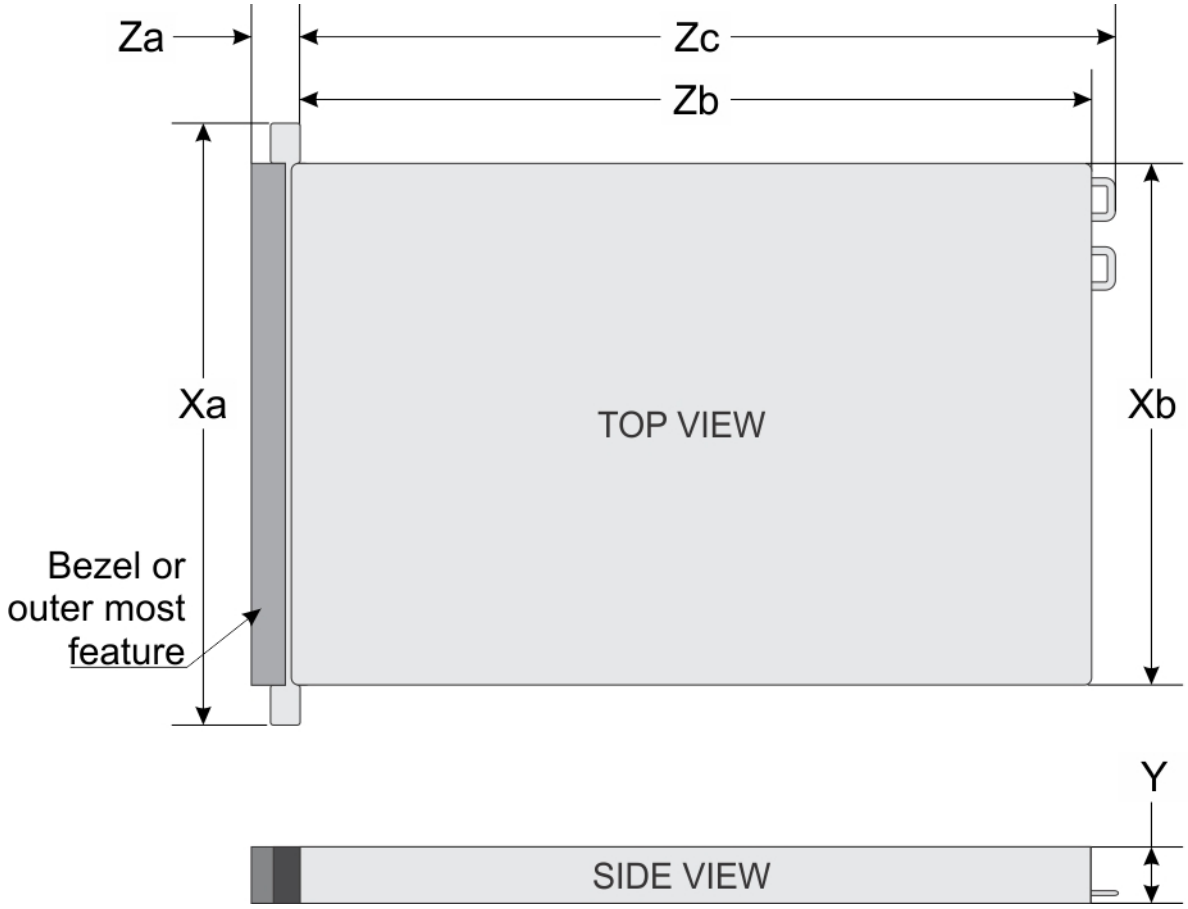
Teknik özellikler

Bu bölümde sisteminizin teknik ve çevresel özelliklerine değinilmiştir.

Konular:

- Kasa boyutları
- Sistem ağırlığı
- İşlemci özellikleri
- PSU teknik özellikleri
- Desteklenen işletim sistemleri
- Soğutma fanı özellikleri
- Sistem pili özellikleri
- Genişletme kartı yükselticisi teknik özellikleri
- Bellek özellikleri
- Depolama denetleyicisi özellikleri.
- Sürücüler
- Bağlantı noktaları ve konektörlerin özellikleri
- Video özellikleri
- Çevre özellikleri

Kasa boyutları



Rakam 1. Kasa boyutları

Tablo 1. Kasa boyutları

Sürücüler	Xa	Xb	Y	Za	Zb	Zc
24 sürücü	482,0 mm (18,97 inç)	434,0 mm (17,08 inç)	86,8 mm (3,41 inç)	22,0 mm (0,86 inç) Çerçevesiz 35,84 mm (1,41 inç) Çerçevesiz	675,04 mm (26,57 inç) Kulaktan L braketi bölmesine 650,24 mm (25,6 inç) Kulaktan PSU yüzeyine	685,78 mm (26,99 inç) Kulaktan velcro şeridi olmayan PSU koluna
12 sürücü						
16 sürücü						
8 sürücü						
Arka panel yapılandırması yok						

NOT: Zb, sistem kartı G/Ç konnektörlerinin bulunduğu nominal arka duvar dış yüzeyini ifade eder.

Sistem ağırlığı

Tablo 2. PowerEdge R750xs sistem ağırlığı

Sistem yapılandırması	Maksimum ağırlık (tüm sürücüler/SSD'ler/çerçeve ile)
24 x 2,5 inç (16 SAS/SATA + 8 NVMe)	23,84 kg (52,55 lb)
16 adet 2,5 inç	21,94 kg (48,36 lb)

Tablo 2. PowerEdge R750xs sistem ağırlığı (devamı)

Sistem yapılandırması	Maksimum ağırlık (tüm sürücüler/SSD'ler/çerçeve ile)
12 x 3,5 inç	28,76 kg (63,40 lb)
8 x 3,5 inç	24,80 kg (54,67 lb)
8 x 2,5 inç	20,44 kg (45,06 lb)
Arka panel yapılandırması yok	18,54 kg (40,87 lb)

İşlemci özellikleri

Tablo 3. PowerEdge R750xs İşlemci teknik özellikleri

Desteklenen işlemci	Desteklenen işlemci sayısı
32 adede kadar çekirdek desteği ile 3. Nesil Intel Xeon Ölçeklenebilir işlemciler	İkiye kadar

PSU teknik özellikleri

PowerEdge R750xs sistem, iki adede kadar AC veya DC güç kaynağı ünitesini (PSU) destekler.

Tablo 4. PSU teknik özellikleri

PSU	Sınıf	Isı dağıtımı (maksimum) BTU/saat	Frekans Hz	Gerilim	AC		DC	Akım
					Yüksek hat 200–240 V	Düşük hat 100 - 120 V		
1400 W Karışık Mod	Platinum	5406	50/60	100–240 V AC, otomatik aralıklı	1400 W	1050 W	Yok	12 A–8 A
	Yok	5406	Yok	240 V DC, otomatik aralıklı	Yok	Yok	1400 W	6,6 A
1100 W Karışık Mod	Titanium	4299	50/60	100–240 V AC, otomatik aralıklı	1100 W	1050 W	Yok	12 A–6,3 A
	Yok	4299	Yok	240 V DC, otomatik aralıklı	Yok	Yok	1100 W	5,2 A
1100 W DC	Yok	4265	Yok	-48–(-60) V	Yok	Yok	1100 W	26,1 A
800 W Karışık Mod	Platinum	3000	50/60	100–240 V AC, otomatik aralıklı	800 W	800 W	Yok	9,2 A-4,7 A
	Yok	3000	Yok	240 V DC, otomatik aralıklı	Yok	Yok	800 W	3,8 A
600 W Karışık Mod	Platinum	2250	50/60	100–240 V AC, otomatik aralıklı	600 W	600 W	Yok	7,1 A-3,6 A
	Yok	2250	Yok	240 V DC, otomatik aralıklı	Yok	Yok	600 W	2,9 A

NOT: Ayrıca bu sistem fazdan faza gerilimi 240 V değerini geçmeyen BT güç sistemlerine bağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

NOT: Isı dağıtımı PSU'nun Watt değeriyle hesaplanır.

NOT: Sistem yapılandırmanızı seçerken veya yükseltirken, en iyi güç kullanımını sağlamak için sistem güç tüketimini **Dell.com/ESSA** adresinde bulunan Dell Energy Smart Solution Advisor (Dell Enerji Akıllı Çözüm Danışmanı) ile doğrulayın.

Desteklenen işletim sistemleri

PowerEdge R750xs sistem aşağıdaki işletim sistemlerini destekler:

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Citrix Hypervisor
- Microsoft Windows Server + Hyper-V
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi


Daha fazla bilgi için www.dell.com/ossupport adresine gidin.

Soğutma fanı özellikleri

Soğutma fanı özellikleri

PowerEdge R750xs sistemi en fazla altı adet Standart fanlar, Yüksek performanslı Silver Sınıfı fanlar veya Yüksek performanslı Gold Sınıfı fanlar destekler.


Tablo 5. Soğutma fanı özellikleri

Fan tipi	Kısaltma	Diğer adı	Etiket rengi	Etiket resmi
Standart fan	STD	STD	Etiket yok	
Yüksek performanslı fan (Silver sınıfı)	HPR SLVR	HPR	Silver	NOT: Yeni soğutma fanları Yüksek Performanslı Silver Sınıfı etiketi taşır. Buna karşılık eski soğutma fanları Yüksek Performans etiketine sahiptir.

Tablo 5. Soğutma fanı özellikleri (devamı)

Fan tipi	Kısaltma	Diğer adı	Etiket rengi	Etiket resmi
				 <p>Rakam 2. Yüksek performanslı fan</p>  <p>Rakam 3. Yüksek performanslı (Silver sınıfı) fan</p>
Yüksek performanslı fan (Gold Sınıfı)	HPR GOLD	VHPR - Çok Yüksek Performans	Gold	<p>NOT: Yeni soğutma fanları Yüksek Performanslı Gold Sınıfı etiketi taşır. Buna karşılık eski soğutma fanları Yüksek Performans etiketine sahiptir.</p>  <p>Rakam 4. Çok yüksek performanslı fan</p>

Tablo 5. Soğutma fanı özellikleri (devamı)

Fan tipi	Kısaltma	Diğer adı	Etiket rengi	Etiket resmi
				 <p>Rakam 5. Yüksek performanslı (Gold sınıfı) fan</p>

i **NOT:** STD, HPR SLVR veya HPR GOLD fanlarının birlikte kullanımı desteklenmez.

i **NOT:** STD, HPR SLVR veya HPR GOLD fanlarının takılması sistem yapılandırmasına bağlıdır. Desteklenen fan yapılandırması veya matrisi hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Termal kısıtlama matrisi](#).

Sistem pili özellikleri

PowerEdge R750xs sistem, CR 2032 3,0 V lityum düğme pil destekler.

Genişletme kartı yükselticisi teknik özellikleri

PowerEdge R750xs sistem en fazla altı adet PCI express (PCIe) Gen 4 genişletme kartını destekler.

Tablo 6. Sistem kartında desteklenen genişletme kartı yuvaları

PCIe yuvası	Genişletme kartı yükselticisi	İşlemci bağlantısı	Yükseklik	Uzunluk	Yuva genişliği
Yuva 1	Yok	İşlemci 1	Düşük Profil	Yarım Uzunluk	x16
Yuva 2	Yok	PCH	Düşük Profil	Yarım Uzunluk	x8 (x4-Link)
Yuva 3	Yükseltici 1A	İşlemci 1	Düşük Profil	Yarım Uzunluk	x16
Yuva 4		İşlemci 2	Düşük Profil	Yarım Uzunluk	x16
Yuva 3	Yükseltici 1B (SNAPI)	İşlemci 1 ve 2	Düşük Profil	Yarım Uzunluk	x16
Yuva 4		İşlemci 2	Düşük Profil	Yarım Uzunluk	x16 (x8-Link)
Yuva 5	Yok	İşlemci 2	Düşük Profil	Yarım Uzunluk	x16
Yuva 6	Yok	İşlemci 2	Düşük Profil	Yarım Uzunluk	x16

i **NOT:** Bütün yapılandırmalarda sadece bir adet kablo yükselticisi takılabilir.

Bellek özellikleri

PowerEdge R750xs sistem en iyi duruma getirilmiş çalışma için aşağıdaki bellek özelliklerini destekler.

Tablo 7. Bellek özellikleri

DIMM tipi	DIMM derecesi	DIMM kapasitesi	Tek işlemci		Çift işlemciler	
			Minimum DIMM kapasitesi	Maksimum DIMM kapasitesi	Minimum DIMM kapasitesi	Maksimum DIMM kapasitesi
RDIMM	Tek aşamalı	8 GB	8 GB	64 GB	16 GB	128 GB
	Çift aşamalı	16 GB	16 GB	128 GB	32 GB	256 GB
		32 GB	32 GB	256 GB	64 GB	512 GB
		64 GB	64 GB	512 GB	128 GB	1 TB

Tablo 8. Bellek modülü soketleri

Bellek modülü soketleri	Hız
16, 288 pin	3200 MT/sn, 2933 MT/sn, 2666 MT/sn

Depolama denetleyicisi özellikleri.

PowerEdge R750xs sistem aşağıdaki denetleyici kartlarını destekler:

Tablo 9. Sistem için depolama denetleyicisi kartları

İç denetleyiciler	Harici denetleyiciler
<ul style="list-style-type: none">PERC H755PERC H755NPERC H745PERC H355PERC H345HBA355iS150Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 x M.2 SSD	<ul style="list-style-type: none">HBA355ePERC H840

NOT: Yazılım RAID denetleyicisi S150, yalnızca yonga seti SATA arka paneli SATA sürücülerde veya işlemci doğrudan PCIe kablosu arka panele bağlı evrensel yuvalardaki NVMe sürücülerde desteklenir.

Sürücüler

PowerEdge R750xs sistem şunları destekler:

- 24 x 2,5 inç (16 SAS/SATA + 8 NVMe) sürücü
- 16 adet 2,5 inç SAS veya SATA sürücü
- 12 x 3,5 inç SAS veya SATA sürücü
- 8 x 2,5 inç SAS veya SATA sürücü
- 8 x 2,5 inç NVMe sürücü
- 8 x 3,5 inç SAS veya SATA sürücü

NOT: NVMe PCIe SSD U.2 aygıtının çalışır durumda değiştirilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Dell Express Flash NVMe PCIe SSD Kullanıcı Kılavuzu* <https://www.dell.com/support> **Tüm Ürünlere Göz At > Veri Merkezi Altyapısı > Depolama Adaptörleri ve Denetleyiciler > Dell PowerEdge Express Flash NVMe PCIe SSD > Belgeler > El Kitapları ve Belgeler.**

Bağlantı noktaları ve konektörlerin özellikleri

USB bağlantı noktalarının özellikleri

Tablo 10. PowerEdge R750xs USB teknik özellikleri

Ön		Arka		Dahili (İsteğe Bağlı)	
USB bağlantı noktası	Yuva noktalarının sayısı	USB bağlantı noktası	Yuva noktalarının sayısı	USB bağlantı noktası	Yuva noktalarının sayısı
USB 2.0 uyumlu bağlantı noktası	Bir	USB 2.0 uyumlu bağlantı noktası	Bir	Dahili USB 3.0 uyumlu bağlantı noktası	Bir
Micro USB 2.0 iDRAC Direct	Bir	USB 3.0 uyumlu bağlantı noktası	Bir		

NOT: Micro USB 2.0 uyumlu bağlantı noktası, yalnızca iDRAC Direct veya bir yönetim bağlantı noktası olarak kullanılabilir.

NOT: USB 2.0 teknik özellikleri, güç bağlantılı USB aygıtlarına güç vermek için tek kablo üzerinde 5 V kaynak sağlar. Birim yükü USB 2.0'da 100 mA ve USB 3.0'da 150 mA olarak tanımlanır. Bir aygıt, USB 2.0'daki bir bağlantı noktasından en fazla 5 birim yük (500 mA); USB 3.0'daki bağlantı noktasından ise 6 birim yük (900 mA) çekebilir.

NOT: USB 2.0 arayüzü, düşük güçlü çevre birimlerine güç sağlayabilir, ancak USB özelliklerine uymalıdır. Harici CD/DVD Sürücüler gibi yüksek güçlü çevre birimlerinin çalışması için harici bir güç kaynağı gerekir.

Seri konektör özellikleri

PowerEdge R750xs sistem, sistemin arkasında 9 pimli konektör Veri Terminali Ekipmanı (DTE) 16550 uyumlu bir adet isteğe bağlı kart tipi seri konektör destekler.

İsteğe bağlı seri konektör kartını takma prosedürü, genişletme kartı dolgu braketine benzer şekilde takılır.

NIC bağlantı noktası özellikleri

PowerEdge R750xs sistem, ana kartta (LOM) LAN'a yerleşik olarak ve isteğe bağlı Open Compute Project (OCP) kartlarına entegre olmak üzere iki adede kadar 10/100/1000 Mb/sn Ağ Arayüzü Denetleyicisi (NIC) bağlantı noktasını destekler.

Tablo 11. Sistem için NIC bağlantı noktası teknik özellikleri

Özellik	Özellikler
LOM	1 GB x 2
OCP kartı (OCP 3.0)	1 GbE x 4, 10 GbE x 2, 25 GbE x 2, 25 GbE x 4, 50 GbE x 2, 100 GbE x 2

VGA bağlantı noktalarının teknik özellikleri

PowerEdge R750xs sistem ön ve arka panellerinde iki DB-15 pinli VGA bağlantı noktası destekler.

Video özellikleri

Dell EMC PowerEdge R750xs sistem 16 MB video çerçeve arabelleğine sahip tümleşik Matrox G200 grafik denetleyicisini destekler.

Tablo 12. Sistem için desteklenen video çözünürlük seçenekleri

Resolution (Çözünürlük)	Yenileme hızı (Hz)	Renk derinliği (bit)
1024 x 768	60	8, 16, 32
1280 x 800	60	8, 16, 32
1280 x 1024	60	8, 16, 32
1360 x 768	60	8, 16, 32
1440 x 900	60	8, 16, 32
1600 x 900	60	8, 16, 32
1600 x 1200	60	8, 16, 32
1680 x 1050	60	8, 16, 32
1920 x 1080	60	8, 16, 32
1920 x 1200	60	8, 16, 32

Çevre özellikleri

i **NOT:** Çevre sertifikaları ile ilgili ek bilgi için www.dell.com/support/home adresinde bulunan Belgeler > Mevzuat Bilgileri bölümündeki *Ürünün Çevresel Veri Sayfası*'na bakın.

Tablo 13. Çalıştırma iklim aralığı kategorisi A2

Sıcaklık	Özellikler
İzin verilen sürekli çalışma	
<= 900 metre (<= 2953 fit) yükseklik için sıcaklık aralıkları	Ekipman doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan 10 ila 35°C (50 ila 95°F)
Nem yüzdesi aralıkları (her zaman yoğunlaşmayan)	-12°C minimum yoğuşma noktasıyla %8 bağıl nem ve 21°C (69,8°F) maksimum yoğuşma noktasıyla %80 bağıl nem arası
Çalışma yüksekliği oranı azalması	Maksimum sıcaklık 900 m (2953 fit) üzerinde 1°C/300 m (1,8°F/984 fit) oranında düşürülür.

Tablo 14. Çalıştırma iklim aralığı kategorisi A3

Sıcaklık	Özellikler
İzin verilen sürekli çalışma	
<= 900 metre (<= 2953 fit) yükseklik için sıcaklık aralıkları	Ekipman doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan 5-40°C (41-104°F).
Nem yüzdesi aralıkları (her zaman yoğunlaşmayan)	-12°C minimum yoğuşma noktasıyla %8 bağıl nem ve 24°C (75,2°F) maksimum yoğuşma noktasıyla %85 bağıl nem arası
Çalışma yüksekliği oranı azalması	Maksimum sıcaklık 900 m (2953 fit) üzerinde 1°C/175 m (1,8°F/574 fit) oranında düşürülür.

Tablo 15. Çalıştırma iklim aralığı kategorisi A4

Sıcaklık	Özellikler
İzin verilen sürekli çalışma	
<= 900 metre (<= 2953 fit) yükseklik için sıcaklık aralıkları	Ekipman doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan 5-45°C (41-113°F).
Nem yüzdesi aralıkları (her zaman yoğunlaşmayan)	-12°C minimum yoğuşma noktasıyla %8 bağıl nem ve 24°C (75,2°F) maksimum yoğuşma noktasıyla %90 bağıl nem arası

Tablo 15. Çalıştırma iklim aralığı kategorisi A4 (devamı)

Sıcaklık	Özellikler
Çalışma yüksekliği oranı azalması	Maksimum sıcaklık 900 m (2953 fit) üzerinde 1°C/125 m (1,8°F/410 fit) oranında düşürülür.

Tablo 16. Tüm kategorilerde ortak gereksinimler

Sıcaklık	Özellikler
İzin verilen sürekli çalışma	
Maksimum sıcaklık geçişi (çalışma ve çalışma dışı için geçerlidir)	Bir saatte* 20°C (36°F) ve 15 dakikada 5°C (9°F), bant için bir saatte 5°C (9°F) NOT: * - Bant donanımı için ASHRAE termal yönergeleri uyarınca bunlar anlık sıcaklık değişiklik oranları değildir.
Çalışma dışı sıcaklık sınırları	-40 ila 65°C (-104 ila 149°F)
Çalışma dışı nem limitleri (Her zaman yoğunlaşmayan)	27°C (80,6°F) maksimum nem noktasıyla %5 ila 95 bağımlı nem.
Maksimum çalışma dışı yükseklik	12.000 metre (39.370 fit)
Maksimum çalışma yüksekliği	3048 metre (10.000 fit)

Tablo 17. Maksimum titreşim özellikleri

Maksimum titreşim	Özellikler
Çalışma	0,21 Grm, 10 dakika boyunca 5 Hz ila 500 Hz değerlerinde (bütün x, y ve z eksenlerinde)
Depolama	10 Hz - 500 Hz değerlerinde 15 dakika için 1,88 Grm (altı kenarın tümü test edilmiştir).

Tablo 18. Maksimum sarsıntı darbesi özellikleri

Maksimum sarsıntı darbesi	Özellikler
Çalışma	6G'nin pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde 11 ms'ye kadar art arda uygulanan altı şok atımı.
Depolama	2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde (sistemin her tarafında tek darbe) art arda uygulanan altı sarsıntı darbesi.

Partikül ve gaz kirliliği teknik özellikleri

Aşağıdaki tabloda herhangi bir BT ekipmanı hasarından ve/veya partikül ve gaz kirlenmesinden kaynaklanan arızalardan kaçınılmasına yardımcı olan sınırlamalar tanımlanmaktadır. Partikül veya gaz kirliliği seviyeleri belirtilen sınırlamaları aşarsa ve ekipmanın hasar görmesine veya arızalanmasına neden olursa, çevre koşullarını düzeltmeniz gerekebilir. Çevresel koşulların iyileştirilmesi müşterinin sorumluluğundadır.

Tablo 19. Partikül kirliliği teknik değerleri

Partikül kontaminasyonu	Özellikler
Hava filtreleme	%95 üst güvenlik sınırıyla ISO 14644-1 uyarınca ISO Sınıf 8 ile tanımlanan veri merkezi hava filtrasyonu. NOT: Bu koşul yalnızca veri merkezi ortamları için geçerlidir. Hava filtreleme gereksinimleri, veri merkezi dışında kullanım için tasarlanmış BT ekipmanı, ofis veya fabrika gibi ortamlar için geçerli değildir. NOT: Veri merkezine giren havanın MERV11 veya MERV13 filtrelemesi olmalıdır.

Tablo 19. Partikül kirliliği teknik değerleri (devamı)

Partikül kontaminasyonu	Özellikler
İletken toz	Havada iletken toz, çinko teller veya diğer iletken parçacıklar bulunmamalıdır. <i>i</i> NOT: Bu koşul, veri merkezi ortamları ve veri merkezi olmayan ortamlar için geçerlidir.
Aşındırıcı toz	<ul style="list-style-type: none"> Havada aşındırıcı toz bulunmamalıdır. Havadaki toz kalıntısının havadaki nem ile eriyebilme noktası %60 bağıl nemden az olmalıdır. <i>i</i> NOT: Bu koşul, veri merkezi ortamları ve veri merkezi olmayan ortamlar için geçerlidir.

Tablo 20. Gaz kirliliği teknik değerleri

Gaz içerikli kirlenme	Özellikler
Bakır Parça Aşınma Oranı	<ANSI/ISA71.04-2013 ile tanımlanan biçimde Sınıf G1 başına ayda 300 Å
Gümüş Parça Aşınma Oranı	ANSI/ISA71.04-2013 tarafından tanımlandığı şekilde <200 Å/ay.

i **NOT:** Maksimum aşındırıcı kirlenme düzeyleri \leq %50 bağıl nemde ölçülmüştür.

Termal kısıtlama matrisi

Tablo 21. Termal kısıtlama matrisi

Yapılandırma		8 x 2,5 inç NVMe	16 x 2,5 inç SAS/ SATA + 8 x 2,5 inç NVMe	12 x 3,5 inç SAS/ SATA	Ortam sıcaklığı
Arka depolama		Arka Sürücü Yok	Arka Sürücü Yok	Arka Sürücü Yok	
CPU TDP/cTDP	105 W	5 x HPR fan 2U STD HSK	5 x HPR silver fan 2U STD HSK	5 x HPR silver fan 2U HPR HSK	35°C
	120 W	5 x HPR fan 2U STD HSK	5 x HPR silver fan 2U STD HSK	5 x HPR silver fan 2U HPR HSK	35°C
	135 W	5 x HPR fan 2U STD HSK	5 x HPR silver fan 2U STD HSK	5 x HPR silver fan 2U HPR HSK	35°C
	150 W	5 x HPR fan 2U STD HSK	5 x HPR silver fan 2U STD HSK	5 x HPR silver fan 2U HPR HSK	35°C
	165 W	5 x HPR fan 2U HPR HSK	5 x HPR silver fan 2U HPR HSK	5 x HPR silver fan 2U HPR HSK	35°C
	185 W	5 x HPR fan 2U HPR HSK	5 x HPR silver fan 2U HPR HSK	5 x HPR silver fan 2U HPR HSK	35°C
	205 W	5 x HPR fan 2U HPR HSK	5 x HPR silver fan 2U HPR HSK	5 x HPR silver fan 2U HPR HSK	35°C
	220 W	5 x HPR fan	5 x HPR silver fan	5 x HPR silver fan	35°C

Tablo 21. Termal kısıtlama matrisi (devamı)

Yapılandırma	8 x 2,5 inç NVMe	16 x 2,5 inç SAS/ SATA + 8 x 2,5 inç NVMe	12 x 3,5 inç SAS/ SATA	Ortam sıcaklığı
Arka depolama	Arka Sürücü Yok	Arka Sürücü Yok	Arka Sürücü Yok	
	2U HPR HSK	2U HPR HSK	2U HPR HSK	

- NOT:** Beş standart fanlı ve beş yüksek performanslı fanlı yapılandırmalarda Fan 1 yuvasına fan dolgu ekinin takılması gereklidir. Arka sürücüler takıldığında bir adet yüksek performanslı fanın (Gold Sınıfı) Fan 1 yuvasına takılması gereklidir.
- NOT:** GPU herhangi bir yapılandırmada desteklenmez.
- NOT:** Yükseltici modülü takılı değilse OCP örtüsü gereklidir.
- NOT:** Tek işlemcili yapılandırmalarda işlemci dolgu eki gereklidir. CPU2 konumuna DIMM dolgu ekinin takılması hava örtüsü olsa da olmasa da gereklidir.

Tablo 22. İşlemci ve ısı emici matrisi

Isı emici	İşlemci TDP
2U STD HSK	< 165 W
2U HPR HSK	>= 165 W

Tablo 23. Etiket referansı

Etiket	Açıklama
STD	Standard
HPR (Silver)	Yüksek performanslı (silver sınıfı)
HPR (Gold)	Yüksek performanslı (gold sınıfı)
HSK	Isı emici
LP	Düşük profil
FH	Tam yükseklik